

2021年3月期決算説明資料

JASDAQ 証券コード：6614

2021年6月

今を見つめなおし
人と社会を一步先へ

1. 事業概要・特長
2. 2021年3月期決算の概要
3. 2022年3月期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

1. **事業概要・特長**
2. 2021年3月期決算の概要
3. 2022年3月期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

商号 **株式会社シキノハイテック**
Shikino High-Tech Co., Ltd.

本店所在地 富山県魚津市吉島829番地

代表者 代表取締役社長 浜田 満広

設立年月 1975年1月

資本金 376百万円

発行済株式数 4,150,000株

決算期 3月末

事業内容 電子システム事業・・・半導体検査・装置関連
マイクロエレクトロニクス事業・・・LSI設計（アナログ・デジタル）、IP開発
製品開発事業・・・画像関連機器、CMOSカメラモジュール

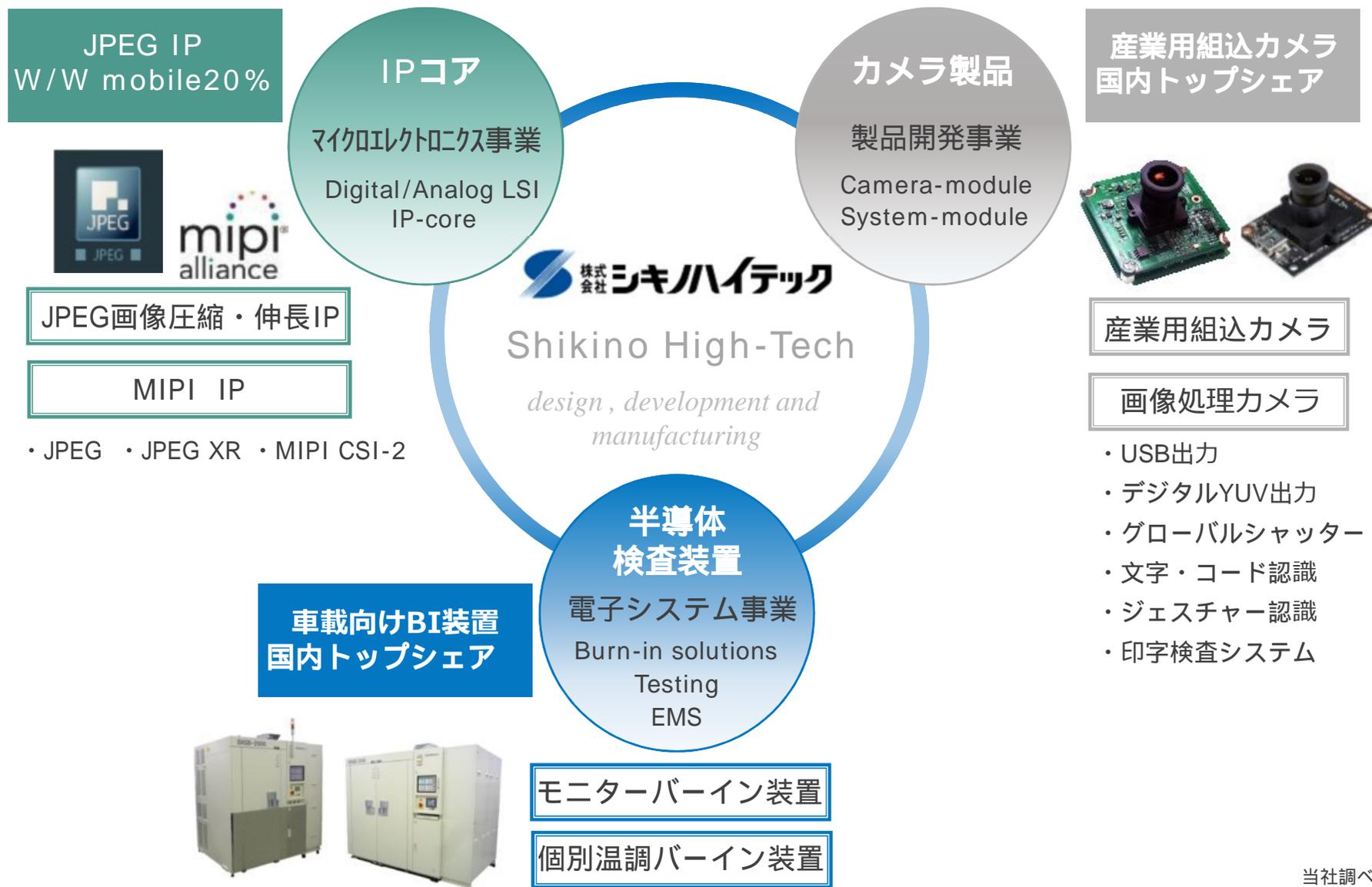
従業員数 355名（2021年4月1日時点）

国内拠点 魚津工場、東京デザインセンター、大阪デザインセンター、福岡デザインセンター
九州事業所

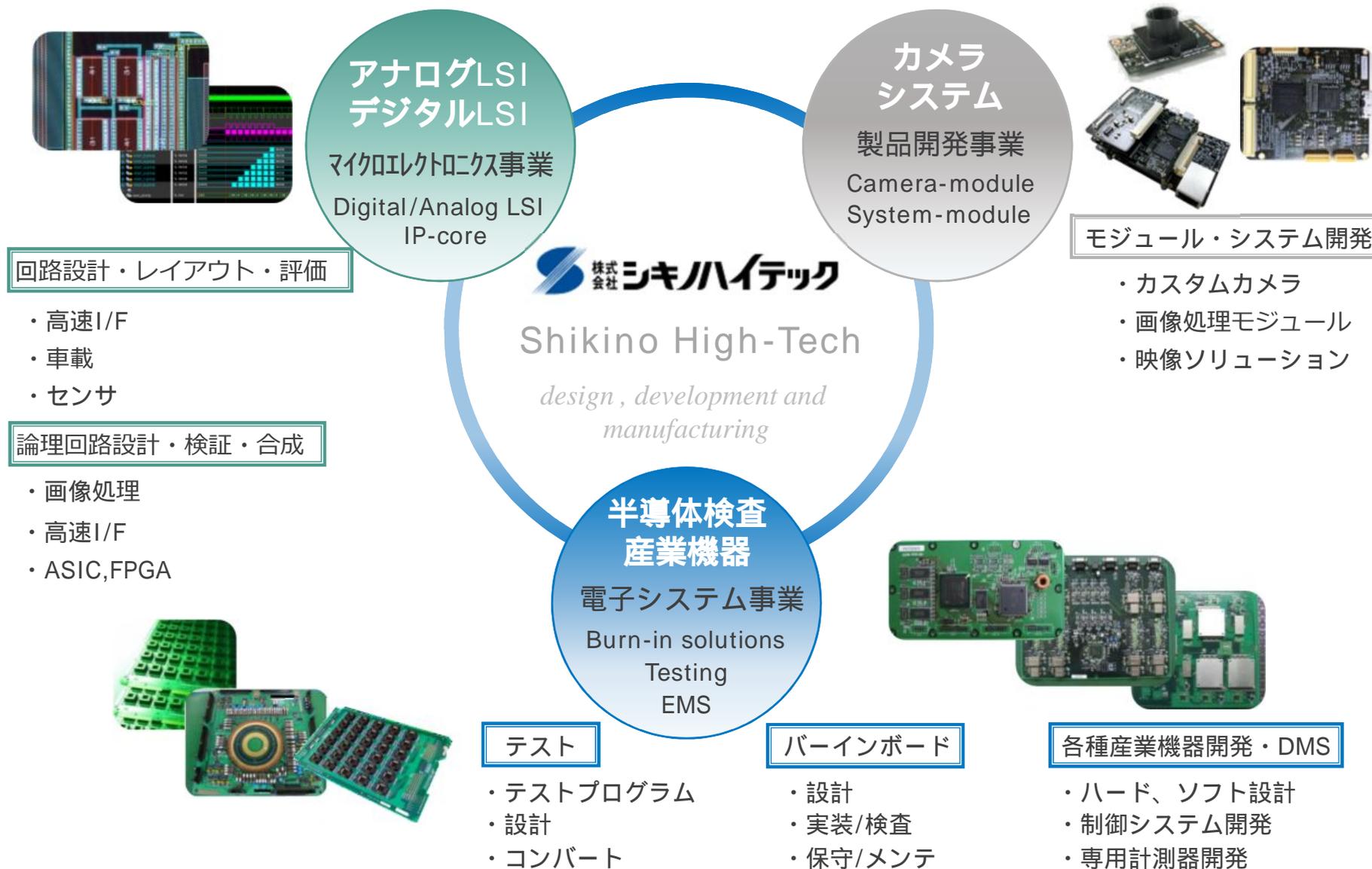
社是
和して拓く

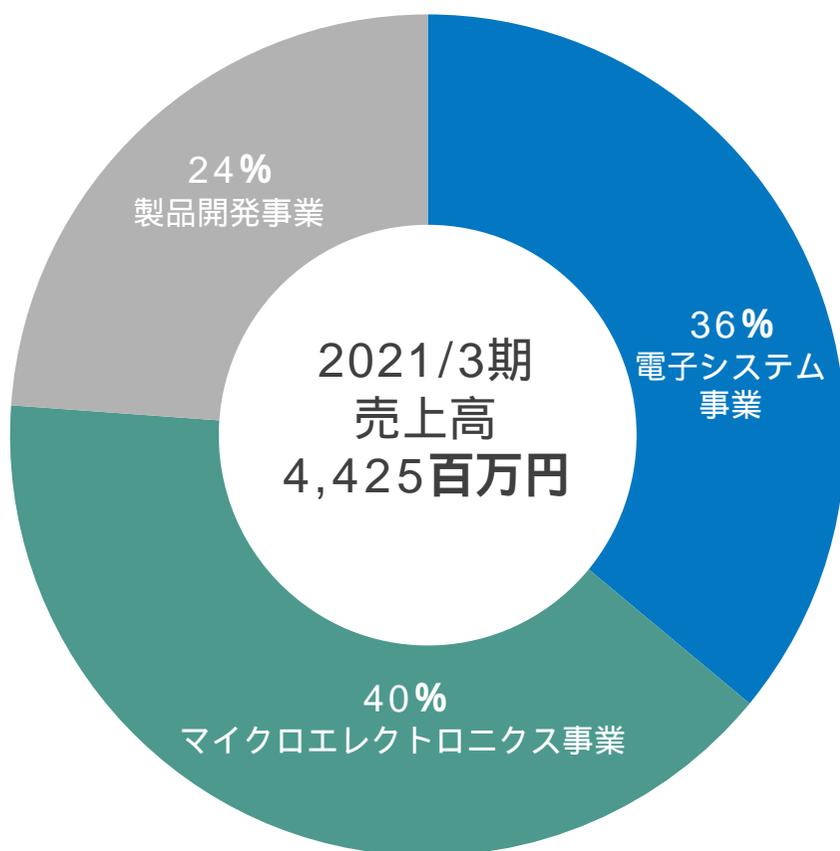
社訓
社業を通じ社会に奉仕
企業の永続と繁栄
社員の幸福と人格の向上

経営理念
我が社は、お客様の信頼を得る製品とサービスを作り出し、立ち止まらず、高いモラルを有し、発展し続ける企業を目指します。



当社調べ





電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）、IP開発

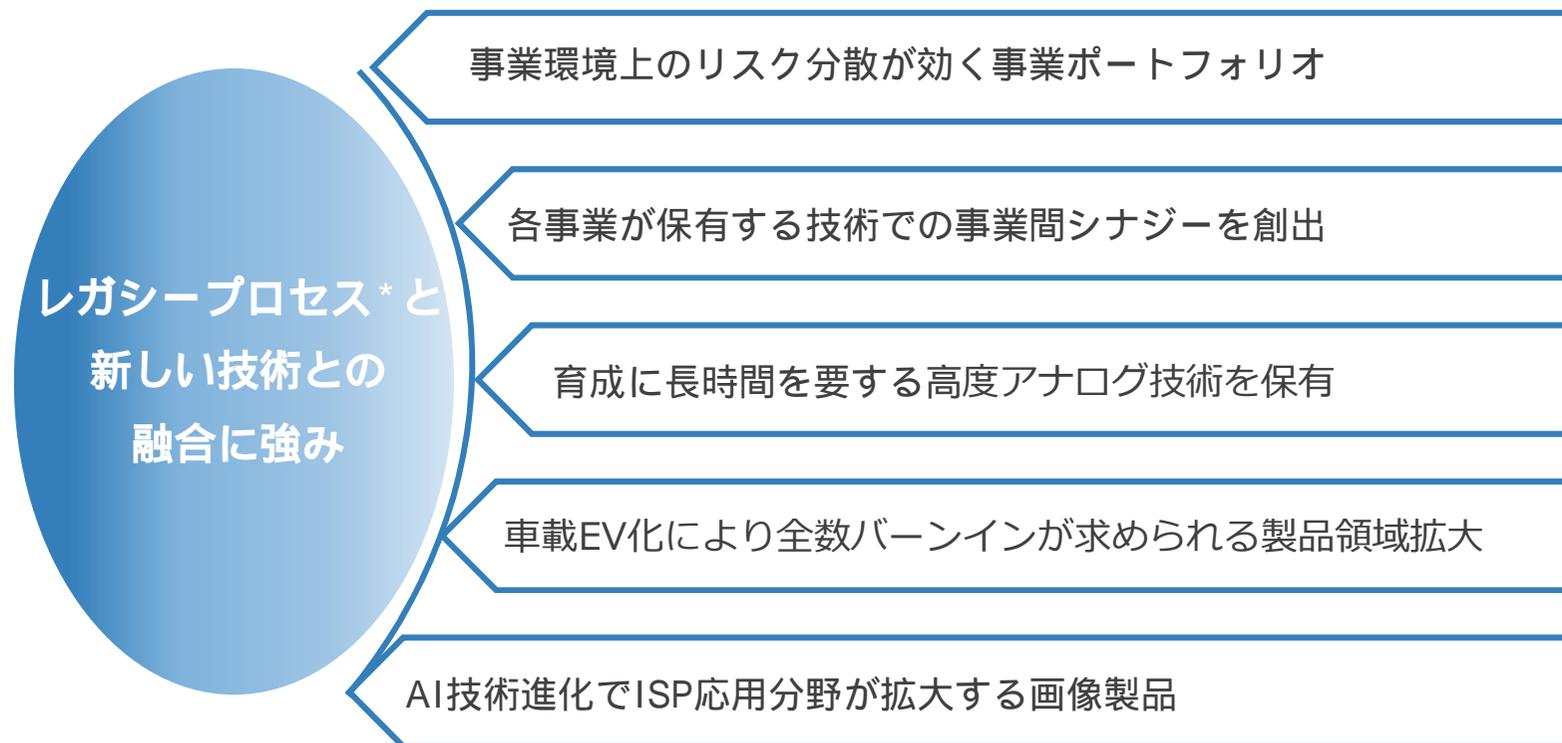
電源IC設計、高速I/F回路設計、イメージセンサ回路設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計
JPEG、MIPI、IPコア

製品開発事業

画像関連機器開発

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

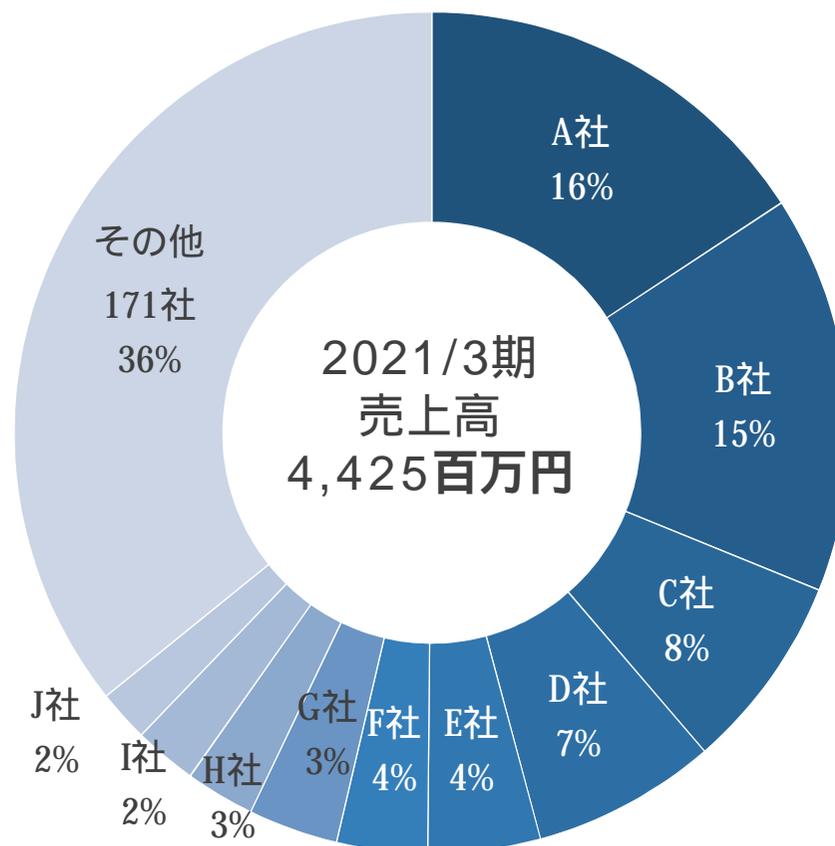
特長のある3つの事業・技術（各種強いアイテムを保有）をコアに、新しい分野に展開



CASE、5G向けの引き合いが旺盛

*レガシープロセス：成熟化した技術、品質の高い製品を仕上げるために熟練技術者のノウハウが必要

主要顧客との安定的な取引と販売先の分散が図られた強固な顧客基盤



1. 事業概要・特長
2. 2021年3月期決算の概要
3. 2022年3月期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

売上高は前期比2.3%減収、経常利益は11.1%減益、当期利益は0.6%減益で着地

売上高は、新型コロナウイルスの影響、及び米中貿易摩擦の影響を受け、2.3%の減収
 経常利益は、高付加価値製品への取り組み、コスト削減の取り組みを行ったことにより、
 概ね前期に近い利益水準となったが、IPO関連費用の計上で減益 11.1%

単位：百万円、%

科目	2020/3期 実績		2021/3期 実績		前期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	増減率
売上高	4,531	100	4,425	100	106	2.3
営業利益	235	5.2	203	4.6	32	13.8
経常利益	235	5.2	209	4.7	26	11.1
当期純利益	113	2.5	113	2.6	0	0.6

電子システム事業

半導体主要顧客の生産調整と新規設備導入の抑制、海外渡航制限
顧客の生産調整に伴う新規設備導入抑制、翌期への案件シフト

売上高：前期比 10.3%

セグメント経常利益： 8百万円
(前期比： 41百万円)

マイクロエレクトロニクス事業

顧客の米中摩擦の影響に伴う開発計画見直しによる受注減少
5G向けサーバの高速I/Fに注力したアナログ、デジタル一括受注が奏功

売上高：前期比： 3.7%

セグメント経常利益： 3.9%

製品開発事業

ビューカメラ、センシングカメラの新規先・既存先へ拡販、マイナンバーカード応用機器向けが好調
医療・介護向けカメラシステムの開発に着手

売上高：前期比： +15.9%

セグメント経常利益： 20百万円
(前期比： +36百万円)

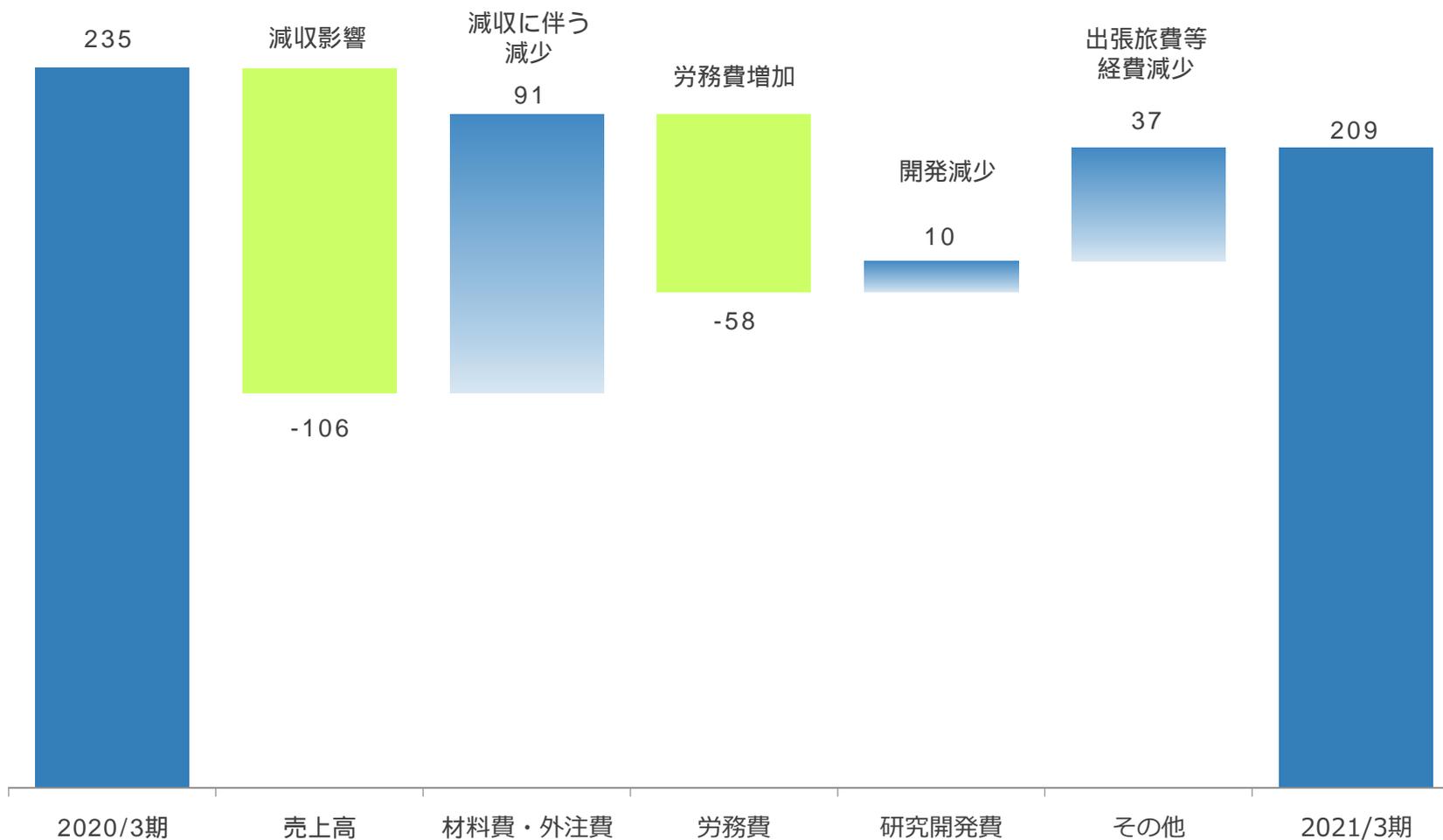
セグメント経常利益：当社内で管理している経常利益ベースでセグメント利益を表しています。

経常利益増減要因（決算概要）

増益要因

減益要因

単位：百万円

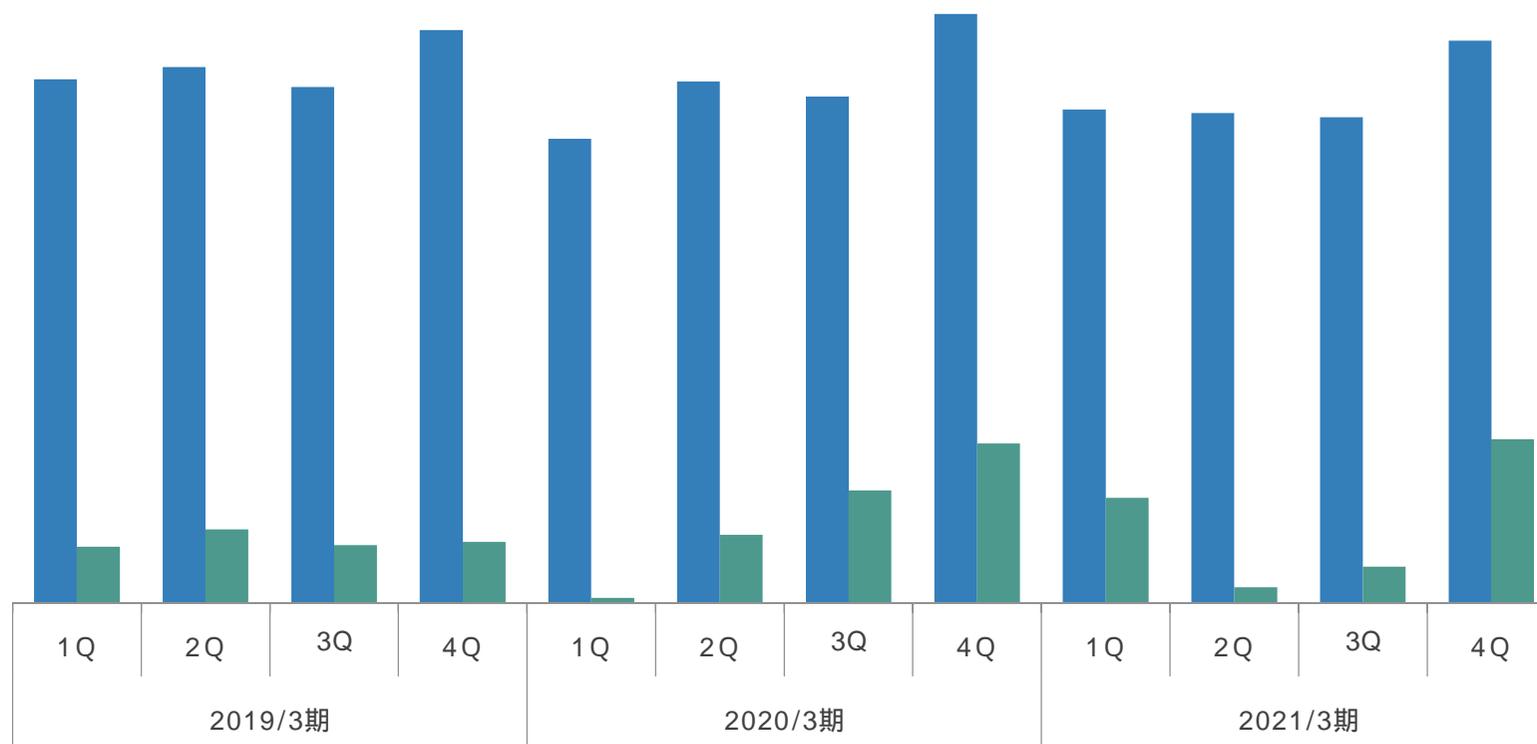


経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整していません。

四半期業績推移イメージ

顧客のプロジェクト（製品開発等）サイクル、当年度の量産開始が下期から開始する傾向などにより、売上・利益ともに4Qが最も高くなる傾向

■ 売上高 ■ 経常利益

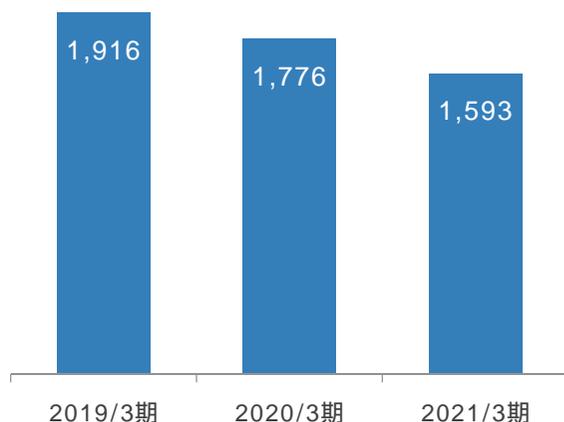


経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

セグメント別実績（電子システム事業）

半導体周辺機器開発により培われた技術で、半導体検査装置・産業機器を提供
（開発～ものづくりまで対応）

【売上高】 (百万円)



半導体検査装置

- ・バーンイン装置
- ・個別温調装置
- ・バーンインボード
- ・半導体テスターアプリケーションボード・アプリケーションプログラム

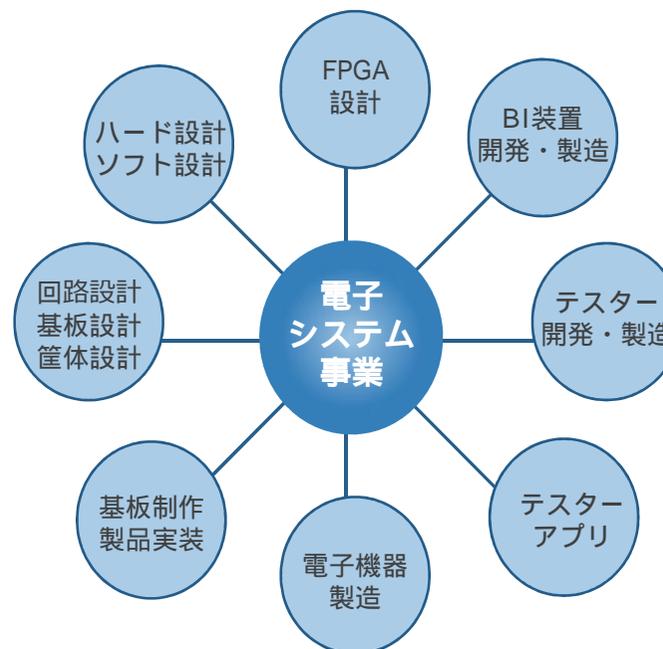
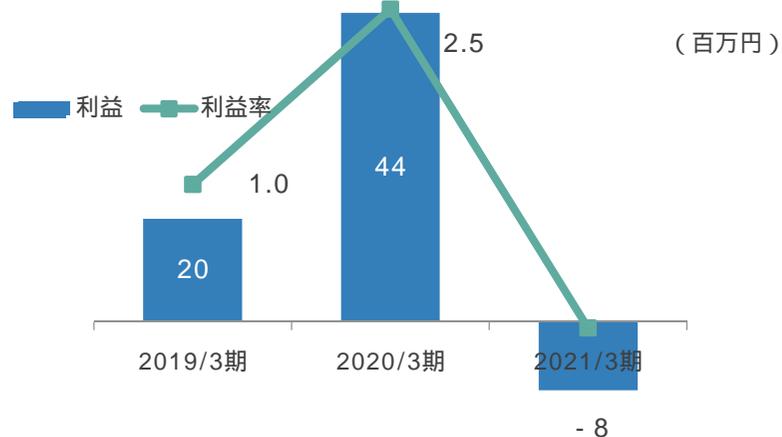


モニターバーンイン装置 SHSB-2000 (48)

産業機器開発

- ・産業用専用計測システム (車載製品向けテスター等)
- ・産業用プログラム

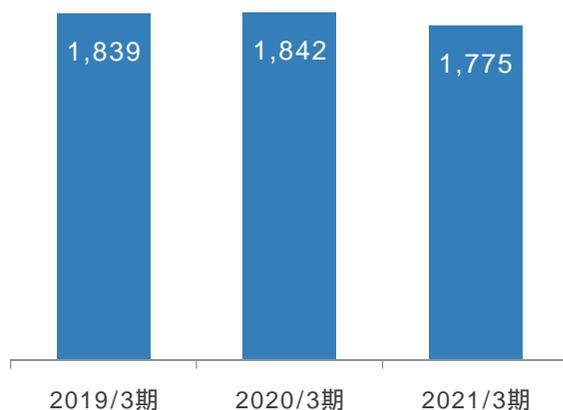
【セグメント経常利益】 (百万円)



高速I/F、電源技術、画像処理技術をコアにしたモバイル、車載機器分野等での一貫開発（設計～評価）に対応

【売上高】

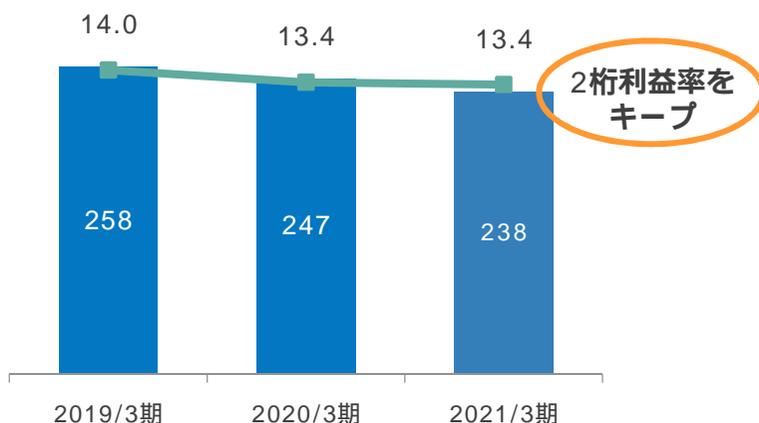
（百万円）



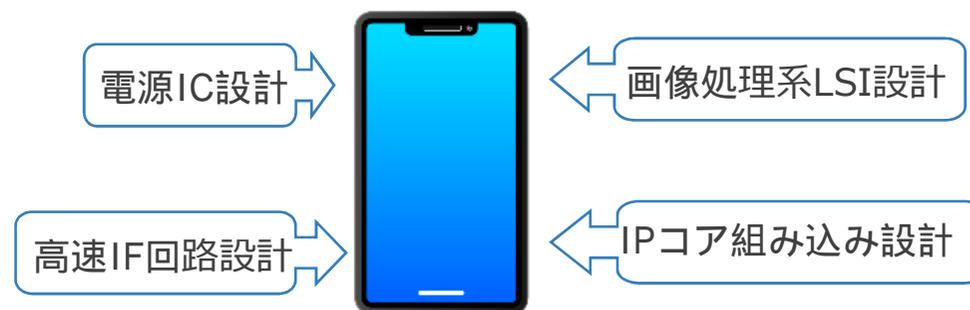
【セグメント経常利益】

■ 利益 ■ 利益率

（百万円）



LSI設計受託（アナログ・デジタル）



豊富なアナログ設計技術者を有し、高速IF・電源ICの設計技術分野で業界トップクラス

IP開発

- ・ JPEG IPコア
- ・ MIPI IPコア



JPEG Baseline IPコア



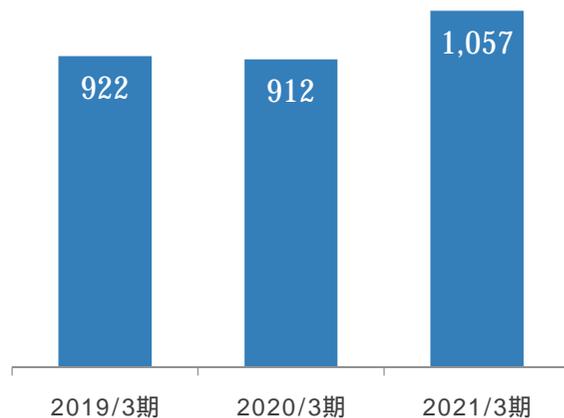
MIPI IPコア製品

JPEG IPは業界トップの実績とライセンス数を保有
Intel Corporationとソリューションでアライアンス

コンビニATM等社会インフラ分野から応用製品（医療・介護関連：ビュー+センシング）への展開
組み込みカメラシステム分野での技術力が強み

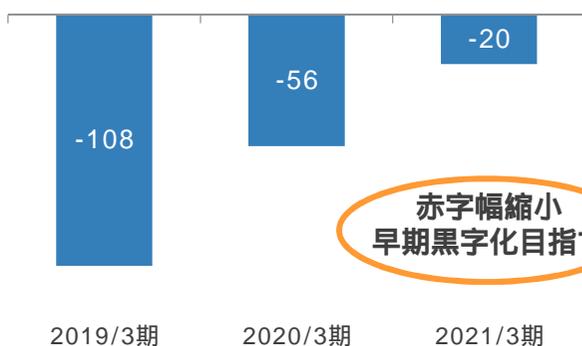
【売上高】

（百万円）



【セグメント経常利益】

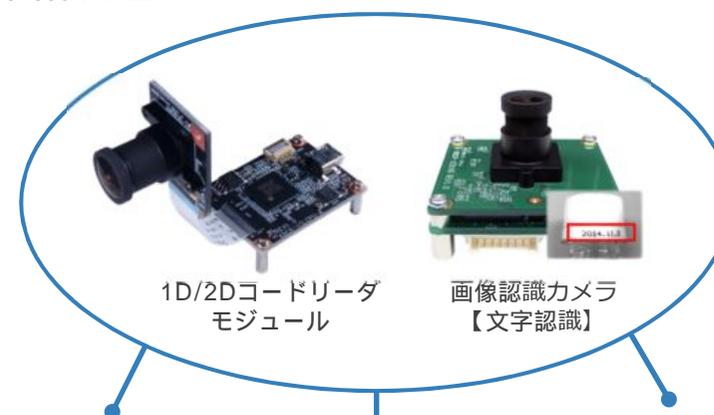
（百万円）



赤字幅縮小
早期黒字化目指す

画像関連機器

- ・ CMOSカメラモジュール
- ・ 画像処理システム
- ・ 画像処理モジュール



ATM



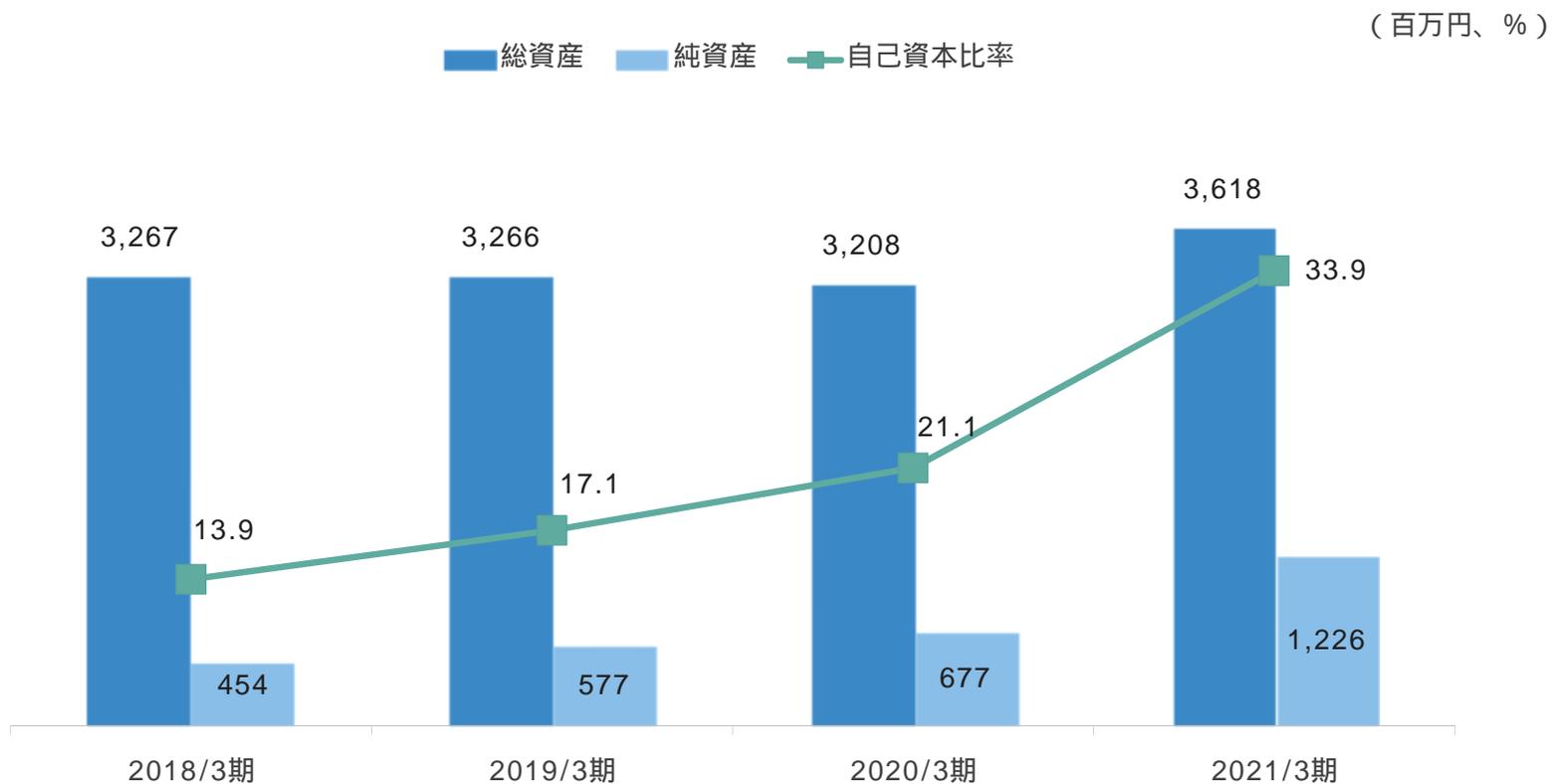
年齢・性別判定カメラ



POS

- ・ コンビニATM用国内シェアトップ 当社調べ
- ・ 用途に応じた最適システムへのカスタマイズ対応
- ・ カメラモジュールを小ロットで供給可能
（多品種少量（中量）生産対応）

自己資本比率は上昇基調で推移



1. 事業概要・特長
2. 2021年3月期決算の概要
- 3. 2022年3月期業績予想の概要**
4. 今後の成長戦略

2022年3月期業績予想の概要

売上高15.2%増、営業利益は6.0%増、経常利益15.4%増、当期純利益48.3%増を予想

半導体の需給逼迫状況は、現状と同水準が年度を通じて継続することを想定
 顧客の生産動向は、緩やかな回復基調を見込む
 次年度以降の成長戦略達成に向け、開発を加速するため研究開発費を増額
 規模拡大に向け、採用を拡充し人財増強（前期比28名増）

(単位：百万円、%)

科目	2021/3期 実績		2022/3期 予想		前期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	増減率
売上高	4,425	100	5,096	100	670	15.2
営業利益	203	4.6	215	4.2	11	6.0
経常利益	209	4.7	241	4.7	31	15.4
当期純利益	113	2.6	168	3.3	54	48.3

電子システム事業

半導体検査商材の受注増及び新分野（センサー、光など）での拡販
車載製品向けの取引回復を見込む

中古販売や検査受託、保守・メンテナンスの強化により受注範囲拡大を図る

売上高：前期比 + 20.7%

セグメント経常利益：41百万円
（前期比：+50百万円）

マイクロエレクトロニクス事業

5G関連領域での一層の受託拡大
米中貿易摩擦の影響一巡で画像、イメージセンサ分野での受託回復を見込む

JPEGとISPのIP開発強化と
グローバル販売への取り組み推進

売上高：前期比：+10.4%

セグメント経常利益：8.7%

製品開発事業

産業機器分野、医療分野への一層の取り組みを強化

センシングカメララインナップの強化と市場開拓推進、

AIカメラでのセンシング技術強化

医療・介護分野での完成品への取り組み

売上高：前期比：+14.9%

セグメント経常利益：17百万円
（前期比：+3百万円）

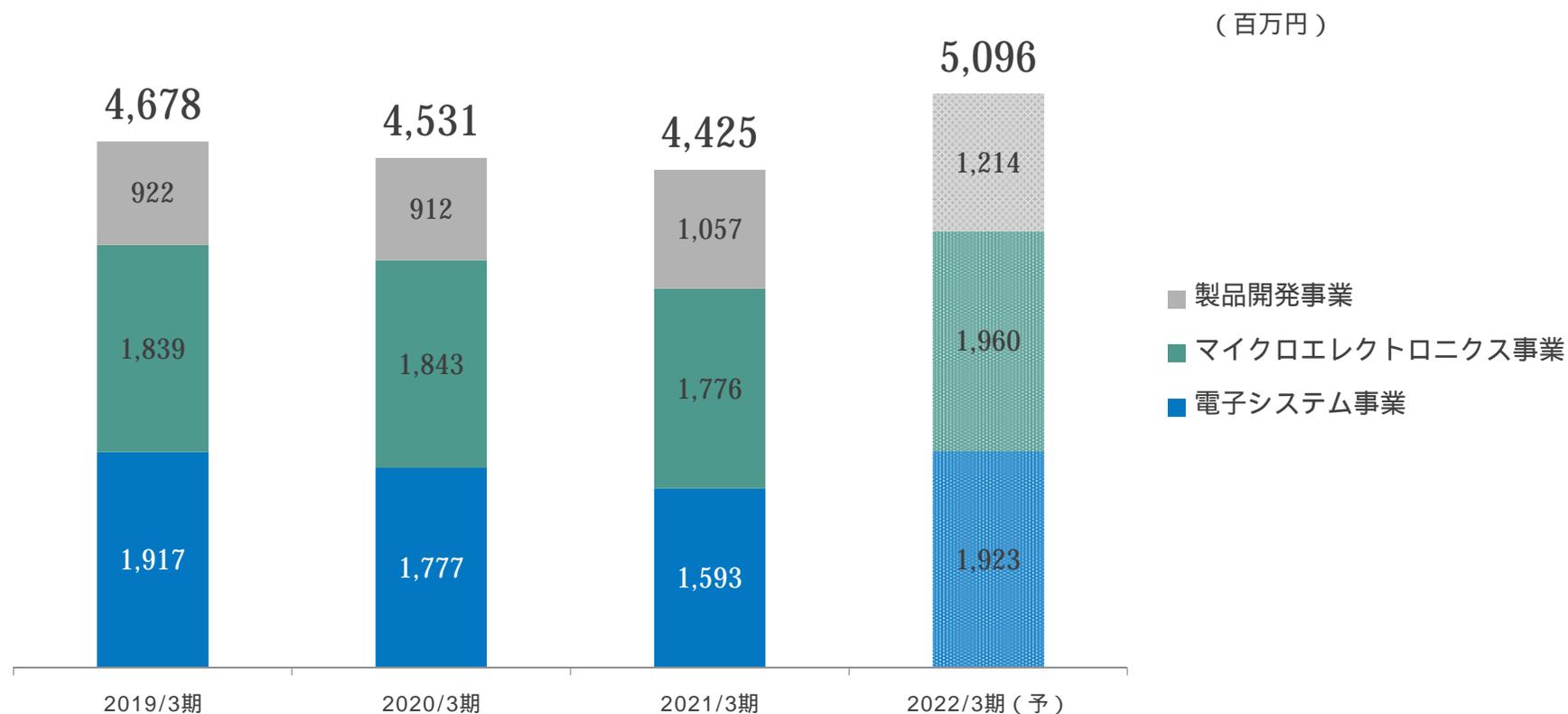
セグメント経常利益：当社内で管理している経常利益ベースでセグメント利益を表しています。

収益を伴う成長戦略の加速

売上高の推移

2021/3期は、新型コロナウイルス、米中貿易摩擦の影響から、電子システム事業とマイクロエレクトロニクス事業が伸び悩むも、製品開発事業は増収

2022/3期は、半導体需要増加に伴い電子システム事業は回復、マイクロエレクトロニクス事業は米中貿易摩擦の影響一巡により回復、製品開発事業は更に増収を予想



経常利益・当期純利益の推移

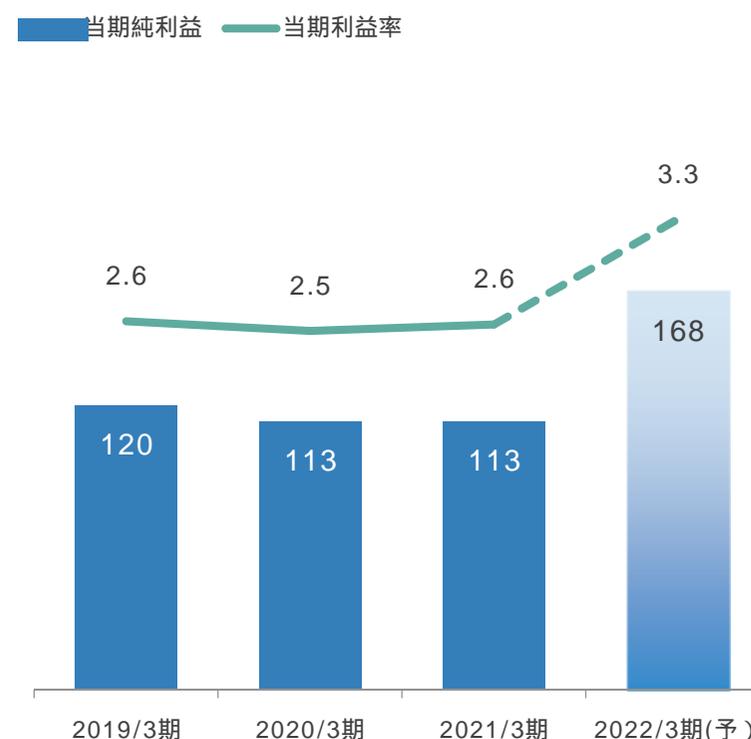
2021/3期は新型コロナウイルスの影響を受けた減収影響や上場関連費用増により減益
2022/3期は、増収増益を予想するが、次年度以降の成長に向けた人財を増強すると共に、研究開発費を大幅に積み増しする

(百万円)

【経常利益】



【当期純利益】

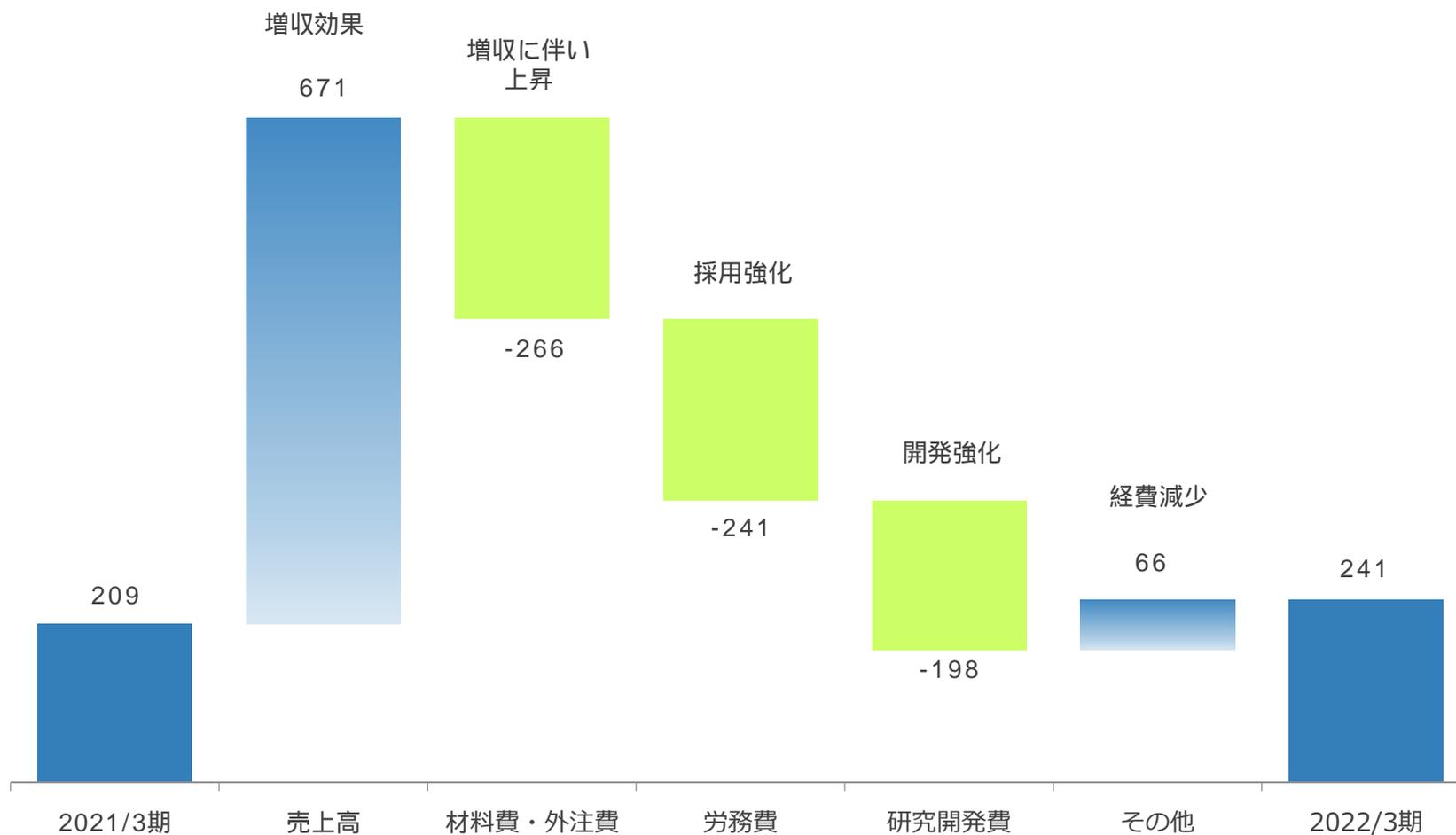


経常利益増減要因（業績予想）

増益要因

減益要因

単位：百万円



経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整していません。

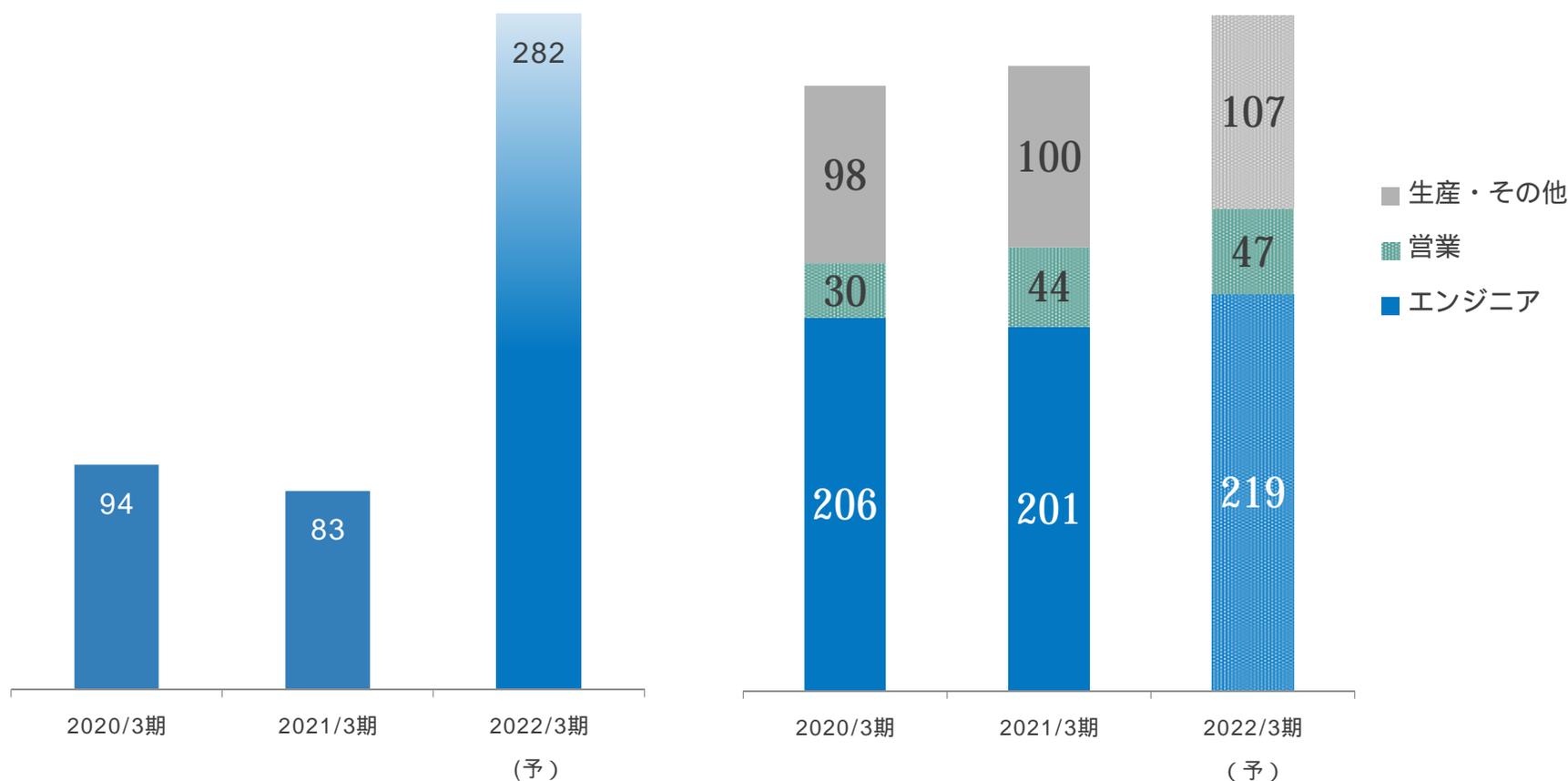
研究開発費・従業員数

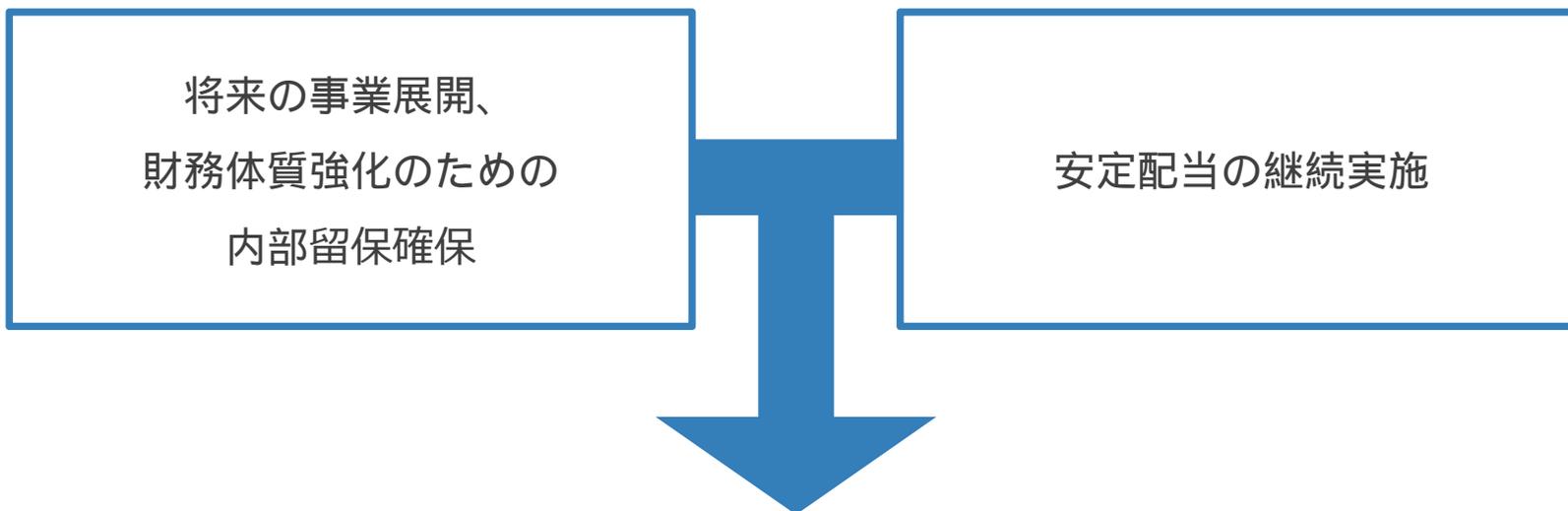
2022/3期は次年度以降の成長に向け、研究開発費の増額を計画するとともに、主に技術を中心に28名の人財を増強

【研究開発費】

【従業員数】

(百万円)



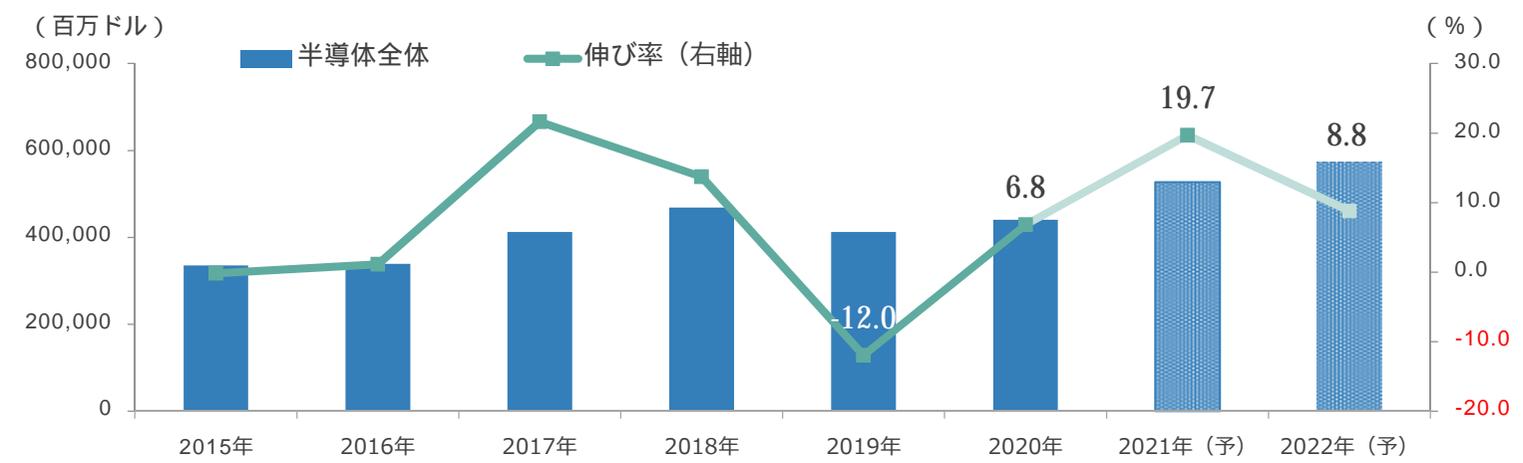
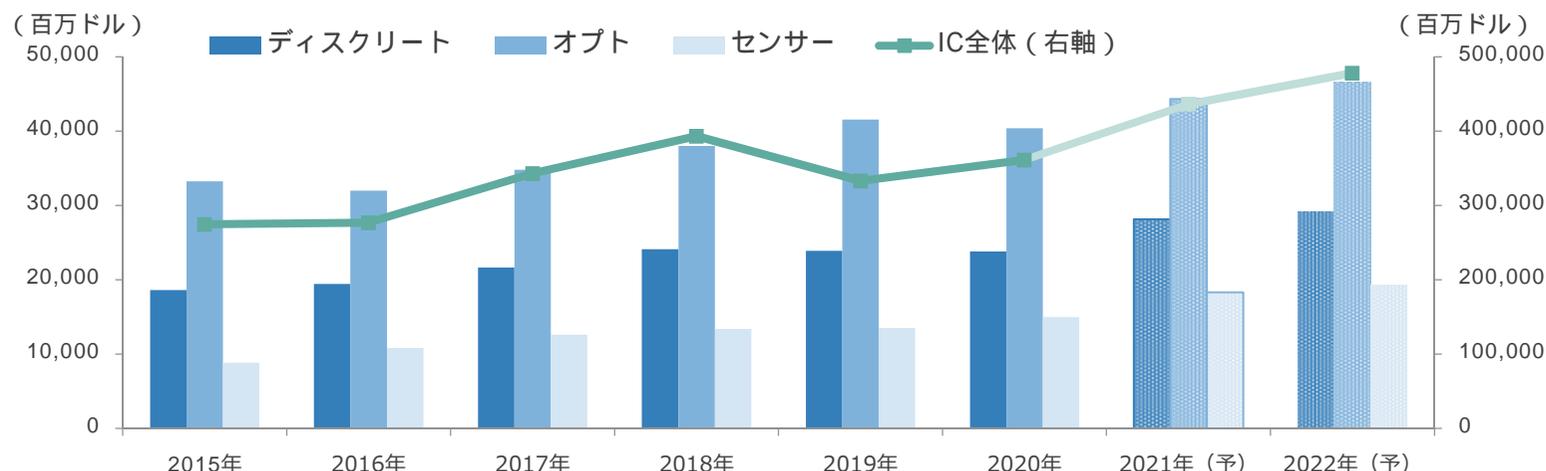


株主への利益還元を重視した経営を推進

内部留保の充実による一層の事業拡大（優秀な人財の確保、新技術導入、独自製品開発に向けた投資）による企業価値向上 株主への利益還元の最大化

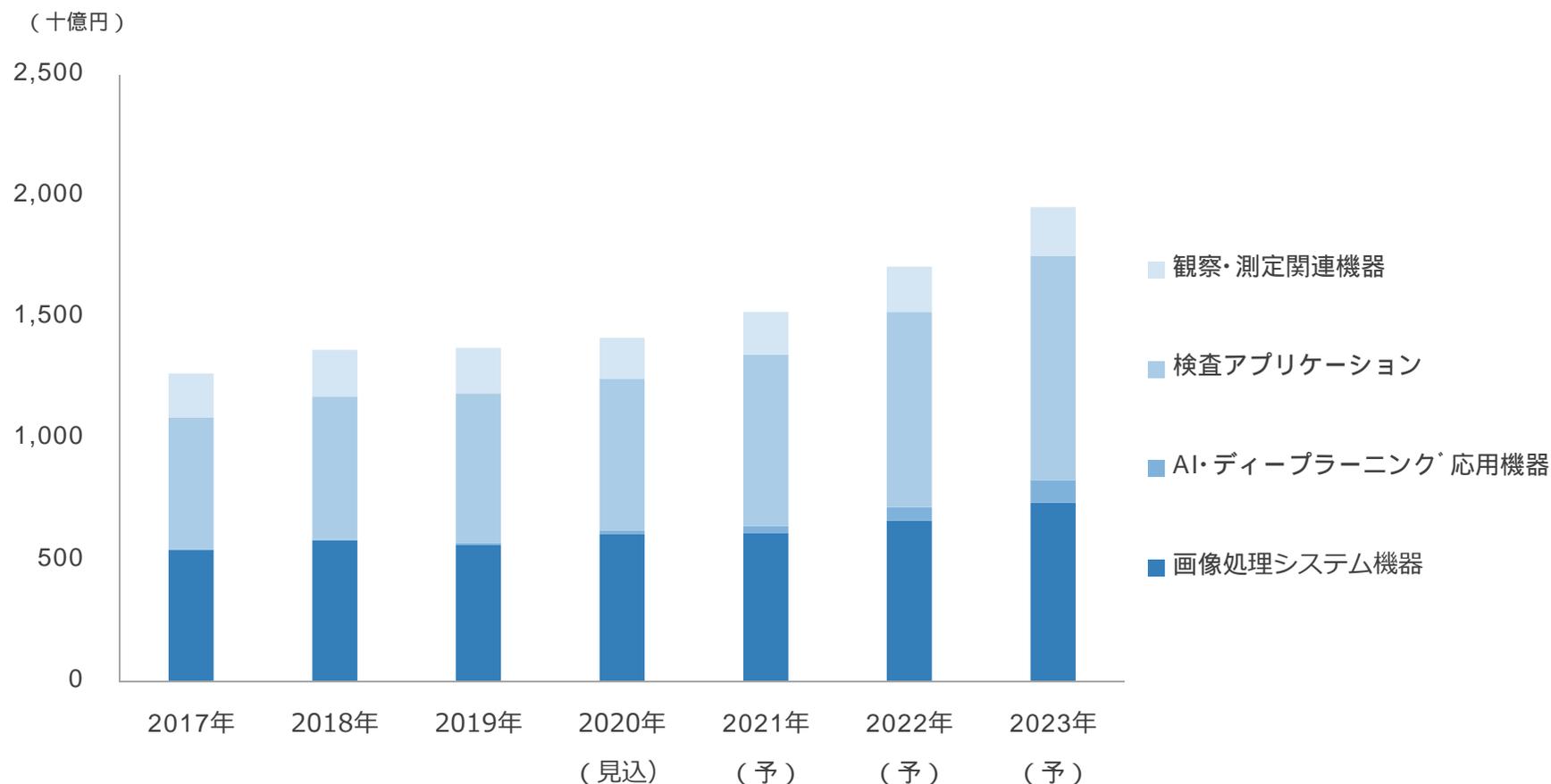
1. 事業概要・特長
2. 2021年3月期決算の概要
3. 2022年3月期業績予想の概要
4. 今後の成長戦略

世界半導体市場は、新型コロナの影響により、パソコン・タブレット、5G関連、データセンター関連機器等巣籠り需要等、半導体をけん引した要因が継続し2桁成長予測
半導体全体では、2021年に前年比+19.7%、2022年に前年比+8.8%を予測



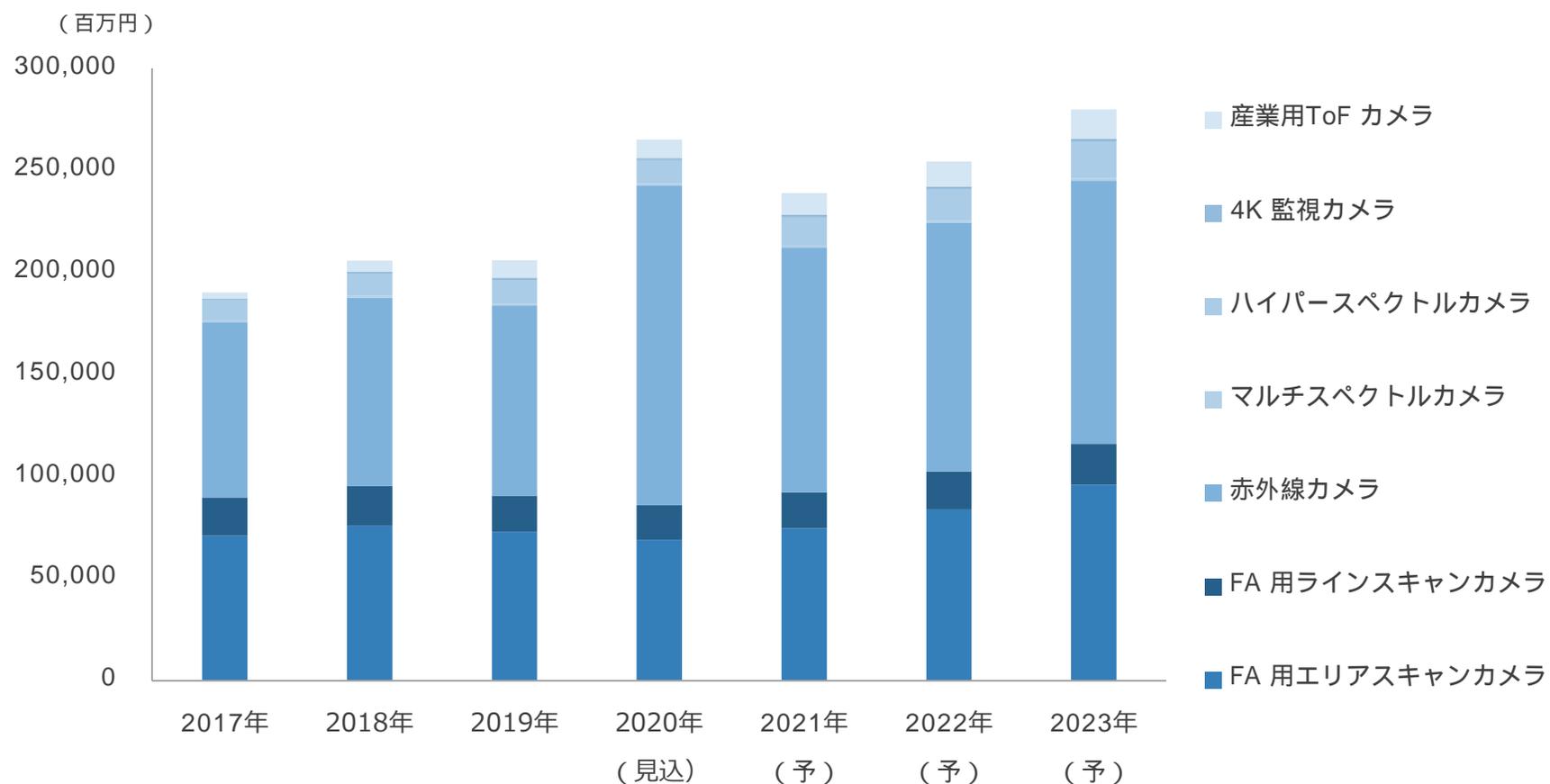
出所：WSTS (WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS : 世界半導体市場統計) 2021年春季半導体市場予測より当社作成

画像処理システム市場は、画像処理システム機器を主体に堅調に推移していたが、AIの応用機器の飛躍的な成長率と検査アプリケーションの堅調な成長を中心に成長加速の予測
 検査アプリケーションは、2021年に前年比+12.8%、2022年に前年比+13.7%を予測



出所：株式会社富士経済「画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

2020年は、コロナ影響による体温検知用赤外線カメラが一時的に増加。
 センサーの高性能化、AIの導入によりカメラ適用分野が拡大し、着実な成長を予測



出所：株式会社富士経済「画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

車載関連、5G、ロボット、AI等の需要拡大（AI+IoTものづくり）に対応

中核事業の競争力強化

電子システム事業・・・BIソリューション（スクリーニング）の受注範囲拡大

マイクロエレクトロニクス事業・・・アナログを強化し新分野への展開、デジタルをソフトウェアで強化

製品開発事業・・・医療関連機器・産業機器への事業領域拡大による販売拡大と利益率改善

新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

電子システム事業・・・新機能（個別温度調節機能等）付きバーンイン装置の開発

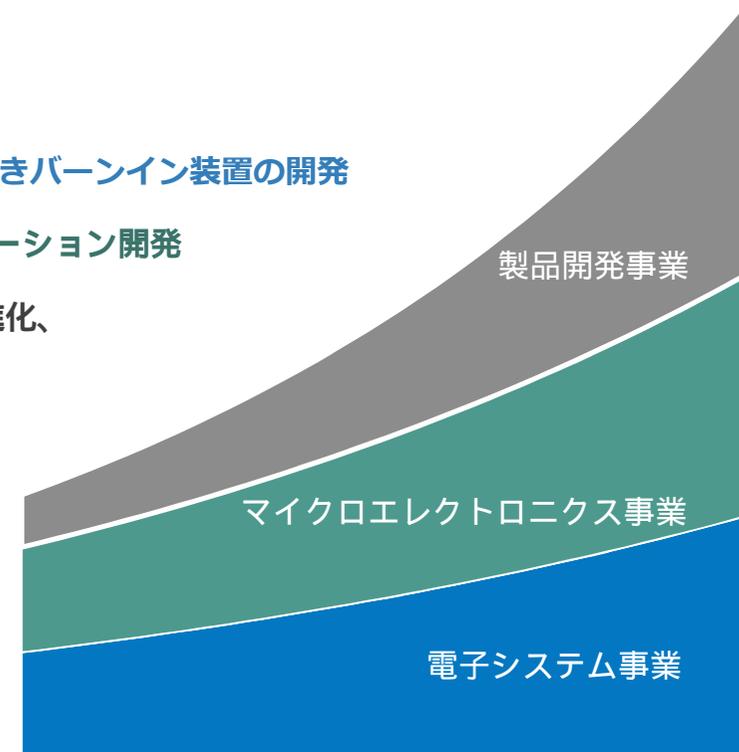
マイクロエレクトロニクス事業・・・JPEGの進化とAI & ISPのソリューション開発

製品開発事業・・・AI技術導入しセンシングカメラ進化、
画像応用製品での事業化推進

新市場、グローバル戦略の拡大

電子システム事業・・・OSATを足掛かりにした海外展開

マイクロエレクトロニクス事業・・・JPEG、画像関連製品の
グローバル展開



電子システム事業・マイクロエレクトロニクス事業の売上拡大・利益率向上
先端技術を追求、ニッチ市場での圧倒的シェア獲得を目指す

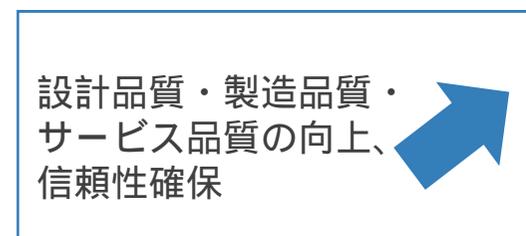
✓ BIソリューション（スクリーニング）の受注範囲拡大



BIシステムのレンタル、中古販売による販売増、アフターメンテ業務の拡大
関連分野の受託検査業務（開発工程、製造工程）に注力

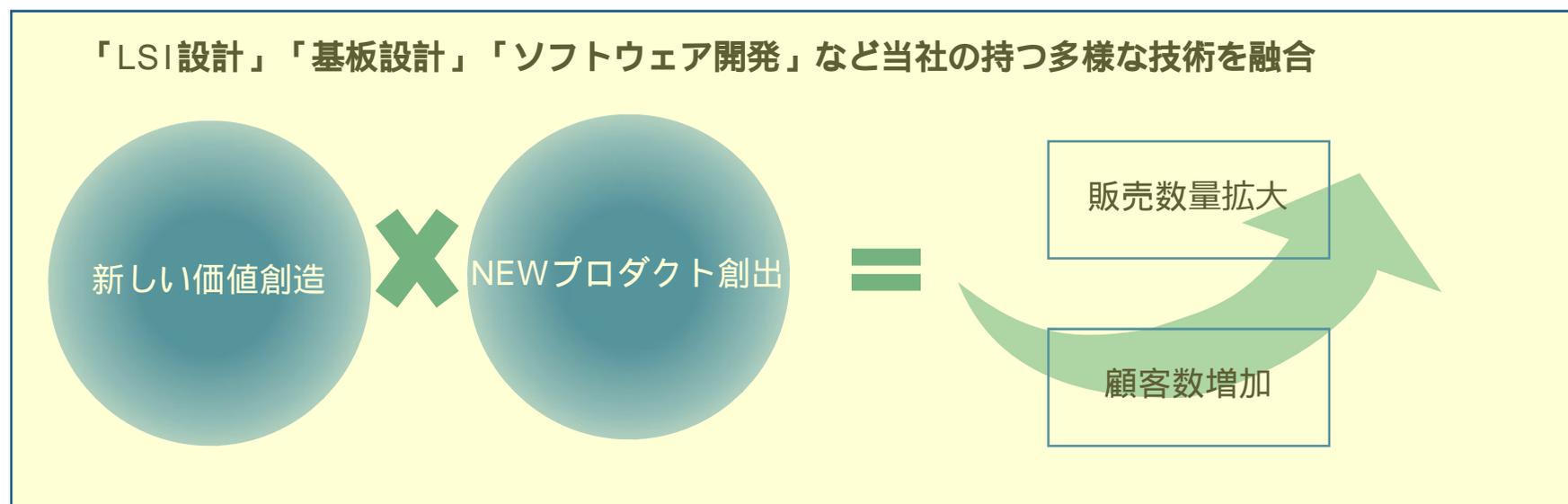
✓ 製造ラインの省人化・省力化の継続的な取り組みによる一層の生産性向上、業務改善の推進

✓ アナログLSI設計の技術力強化（人財・上流設計）による付加価値向上、存在感アップ



製品ラインナップの拡充による顧客層の拡大（ビジネスアイテム追加）

- ✓ 個別温調装置（BIソリューション）の開発 センサー、光分野への拡大
- ✓ JPEG新規格の開発、AI & ISPのソリューション開発



- ✓ 設計技術力を活かした1チップ開発への取り組み
 - ✓ カメラ + 応用製品（センシング等）の展開
- 産業用ロボットを含めたIoT関連分野
車載、医療、通信分野のビジョンソリューション

電子システム事業における、OSATを足掛かりにした海外展開

OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test: 後工程のアセンブリとテスト工程を請負会社)

マイクロエレクトロニクス事業でのJPEG、画像関連製品のワールドワイド展開



顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して優位性のある技術・製品の開発に取り組む

研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、IPコア、高速IF回路、画像処理システム、カメラの性能向上、新機能開発

電子システム事業

・半導体検査装置・個別温調装置・HD-PLC

マイクロエレクトロニクス事業

・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

製品開発事業

・エッジAI・高画素インテリジェントカメラ・介護向けシステム

ご清聴ありがとうございました

本資料および決算説明会で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

【お問い合わせ先】

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>

APPENDIX



バーンイン（ボード）	バーンインは、半導体の初期不良を除去する選別方法の1種。バーンインボードは、通常の使用環境であれば2～3年以内で故障するおそれのある半導体を取り除くテスト工程（パッケージバーンインテスト）で用いられる基板。半導体製品の動作を検証、初期不良品を選別。
LSI	大規模集積回路。ICのうち、素子の集積度が1,000個～10万個程度のものを「MSI」（Medium Scale Integration）、1万ゲート位までのものを「LSI」と呼ぶ。これ以上はVLSI（Very Large Scale Integrated Circuit）と呼ばれている
IC	半導体集積回路。トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの素子を集めて基板の上に装着し、各種の機能を持たせた電子回路。（Integrated Circuit）
I/F回路（アイエフ回路）	受信機・通信機において周波数変換された信号を処理する電子回路。
FPGA	プログラムすることができる論理LSI。マイクロプロセッサやASIC（特定用途のために設計されたIC）の設計図を送り込んでシミュレーションすることが可能。（Field Programmable Gate Array）
ASIC	特定の用途のために設計されたIC。フルカスタムICは注文に応じてゼロから設計、セミカスタムICはあらかじめ特定の機能を持った回路ブロックを組み合わせた「半完成品」をもとに、配線を変えることで要求に合わせたもの。（Application Specific Integrated Circuit）
JPEG	静止画像データの圧縮方式の一つ。圧縮の際に若干の画像劣化を許容する（劣化許容レベルの指定が可能）方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことが可能、現在のデジタルカメラのほとんどは、記録画像のファイル形式にJPEGを使用。（Joint Photographic Experts Group）
IP	再利用可能な設計資産（知的財産）。ICの設計と製造の分業化により、IPが独自の市場を形成。（Intellectual Property）
MIPI	企業団体MIPI Alliance(本部米国：ノキア、テキサス・インスツルメンツ等により設立)が策定する、モバイル機器のカメラやディスプレイとのインターフェイス規格。（Mobile Industry Processor Interface）
CMOS	半導体の一方式であるMOS（半導体の中で動いている自由電子が、自由電子が飛び出した後の正孔のいずれかによって電荷が運搬されるトランジスタ）を改良したもので、電荷の運搬に自由電子と正孔の両方を用いるため、MOSに比べて動作速度が高い特徴があります。（Complementary Metal Oxide Semiconductor）

